

Jetzt anmelden:  
[epp.industrie.de/  
 innovationsforum-deutschland-2023](http://epp.industrie.de/innovationsforum-deutschland-2023)  
 Vorträge live vor Ort!



**EPP**  
**Innovations  
 FORUM**  
 Deutschland

**11. EPP InnovationsFORUM Deutschland**

**Wettbewerbsfähige Elektronikfertigung**

**in Deutschland**

**29. Juni 2023**  
 9:00 bis 16:30 Uhr  
 Filderhalle Leinfelden

Das EPP InnovationsFORUM ist die führende, unabhängige Veranstaltung im Bereich Fertigung elektronischer Baugruppen.

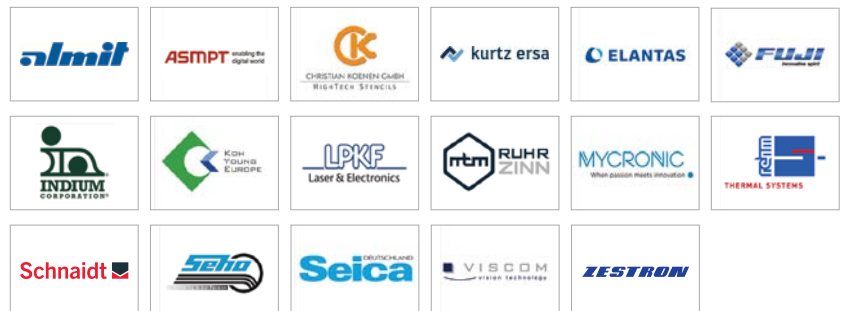
Schwerpunktthemen der Veranstaltung sind:

- Nachhaltig. Energieeffizient. Ressourcenschonend
- Verkürzte Lieferketten durch Reshoring
- Digital. Vernetzt. Smart
- Smarte Produktion ermöglichen
- Daten im Zeitalter der Digitalisierung

**Jetzt  
 anmelden!**

**Ihr  
 Promo-Code**  
**CKOENEN23IFD**

Unsere  
 Premium-Partner:



Unterstützender  
 Partner:



Unsere  
 Basis-Partner:



	Panoramasaal	Kleiner Saal
Ab 8:00 Uhr	Registrierung	
09:00 - 09:10 Uhr	<b>Begrüßung:</b> Doris Jetter, <i>Chefredakteurin EPP / EPP Europe</i>	
09:10 - 10:10 Uhr	<b>Keynote: Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Gesellschaft</b> Prof. Dr. Wolfgang Ertel <i>Institut für Künstliche Intelligenz, Hochschule Ravensburg-Weingarten</i>	
10:10 - 10:40 Uhr	<b>Secondary First! Vom Abfall zum Wertstoff</b> Lothar Pietrzak <i>Senior Consultant   MTM Ruhrzinn GmbH</i>	<b>Mitarbeiter effizienter einsetzen - Wettbewerbsfähige Elektronikfertigung in Zeiten des Fachkräftemangels</b> Oliver Hagemes <i>Technischer Vertrieb   Schnaidt GmbH</i>
10:40 - 11:10 Uhr	<b>Kaffeepause   Networking</b>	
11:10 - 11:40 Uhr	<b>Schablonendruck auf dem Weg in die dritte Dimension</b> Frank Breer <i>Key Account- &amp; Business Development Manager   Christian Koenen GmbH</i>	<b>Viscom AI Solution - The Next Level of Effective Inspection Processes</b> Thomas Winkel <i>Vertrieb Europa   Viscom AG</i>
11:40 - 12:10 Uhr	<b>High-End Lötendraht - der Garant für zuverlässiges automatisiertes Löten</b> Michael Mendel <i>Geschäftsführer   ALMIT GmbH</i>	<b>Servitization - Vom Produkt- zum Lösungsanbieter</b> Christian Rückert <i>Bereich Anwendungstechnologie</i> Jörg Nolte <i>Chief Innovation Manager   Ersä GmbH</i>
12:10 - 12:40 Uhr	<b>Alkoholbasierte Flussmittel: Alternativen und Maschinenteknik in Wellen- und Selektiv-Lötprozessen</b> Dr. Ronny Horn <i>Key Account Manager   SEHO Systems GmbH</i>	<b>Smarte Bedienerführung steigert Effizienz und Zufriedenheit der Bediener in der Elektronikfertigung</b> Thomas Marktscheffel <i>Director Product Management Software Solutions   ASMPT GmbH &amp; Co.KG</i>
12:40 - 14:00 Uhr	<b>Mittagessen   Lunch</b>	
14:00 - 14:30 Uhr	<b>Energieeffizientes Reflow Löten durch weiterentwickelte Lot-Werkstoffe</b> Andreas Karch <i>Technologe - Neue Anwendungen   Technischer Manager   Indium Corporation of America</i>	<b>Flexibles und hochautomatisiertes Laser-Nutzentrennen</b> Patrick Stockbrügger <i>Produktmanager   LPKF Laser &amp; Electronics AG</i>
14:30 - 15:00 Uhr	<b>Dampfphasenlöten - One For All</b> Dr. Paul Wild <i>Leiter Forschung &amp; Entwicklung   Rehm Thermal Systems GmbH</i>	<b>Neue Dimensionen in der Elektronikfertigung</b> Harald Eppinger <i>Managing Director   Koh Young Europe GmbH</i>
15:00 - 15:30 Uhr	<b>Kaffeepause   Networking</b>	
15:30 - 16:00 Uhr	<b>Umweltfreundliche und effiziente Baugruppenreinigung</b> Martin Mattes <i>Senior Prozessingenieur   ZESTRON Europe... a Business Division of Dr. O.K. Wack Chemie GmbH</i>	<b>Flying-Probe-Technologie und Innovation in der Elektronikfertigung: Wie Seica bei der Bewältigung von Herausforderungen in einer sich schnell verändernden Welt und Produktionsumfeld unterstützt!</b> Thomas Hirschfeld <i>Area Sales Manager   Seica</i> Henrik Brüggling <i>Area Sales Manager   Seica</i>
16:00 - 16:30 Uhr	<b>Neuentwicklungen bei Gießharzen: Silikon, Polyurethan- und Epoxy-Systeme mit hohen Temperaturen und hoher Wärmeleitfähigkeit</b> Jens Bürger <i>Technical Sales Manager   ELANTAS Europe GmbH</i>	<b>Artificial Intelligence for AOI - The International Electronics Manufacturing Initiative (iNEMI)</b> Wolfgang Heinecke <i>Head of Product Management   Myconic AB</i>
ab 16:30 Uhr	<b>Verabschiedung</b>	